

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和5年5月15日(2023.5.15)

【公開番号】特開2022-165642(P2022-165642A)

【公開日】令和4年11月1日(2022.11.1)

【年通号数】公開公報(特許)2022-201

【出願番号】特願2021-71065(P2021-71065)

【国際特許分類】

H 05 K 1/02(2006.01)

10

H 05 K 3/46(2006.01)

H 05 K 3/28(2006.01)

H 05 K 3/00(2006.01)

【F I】

H 05 K 1/02 J

H 05 K 3/46 B

H 05 K 3/28 A

H 05 K 1/02 A

H 05 K 3/00 N

20

【手続補正書】

【提出日】令和5年5月2日(2023.5.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

絶縁基板と、

30

前記絶縁基板の表面に設けられ、前記絶縁基板上に形成された溝によって分割されている表面金属層と、

前記絶縁基板の内部に配置されている配線層とを備えている配線基板であって、

前記配線層は、上面視で前記溝の形成領域と重ならないように、前記溝の形成領域を迂回して配置されており、

前記溝の周囲には、絶縁コート層が設けられ、

前記配線層は、上面視で前記絶縁コート層の形成領域と重ならないように、前記絶縁コート層の形成領域を迂回して配置されている、配線基板。

【請求項2】

前記絶縁基板の内部には、内部金属層がさらに設けられており、

前記内部金属層には、上面視で前記溝の形成領域と重なる領域に、前記溝の形成領域の全てを含むように開口が形成されている、

請求項1に記載の配線基板。

40

【請求項3】

絶縁基板と、

前記絶縁基板の表面に設けられている表面金属層と、

前記絶縁基板の内部に配置されている配線層と、

前記表面金属層の一部を覆うように配置されている絶縁コート層とを備えている配線基板であって、

50

前記配線層は、上面視で前記絶縁コート層の形成領域と重ならないように、前記絶縁コート層の形成領域を迂回して配置されている、配線基板。

【請求項 4】

前記絶縁基板の内部には、内部金属層がさらに設けられており、

前記内部金属層には、上面視で前記絶縁コート層の形成領域と重なる領域に、前記絶縁コート層の全ての形成領域を含むように開口が設けられている、

請求項 3 に記載の配線基板。

【請求項 5】

前記配線層は、前記絶縁基板の表面からの距離が 0.5 mm 以内の位置に設けられている、
請求項 1 から 4 の何れか 1 項に記載の配線基板。

10

【請求項 6】

前記内部金属層は、前記絶縁基板の表面からの距離が 0.5 mm 以内の位置に設けられている、
請求項 2 または 4 に記載の配線基板。

10

20

30

40

50